

“陕西省半导体应用产业联盟”成立大会顺利召开

9月5日下午,在陕西省发改委与西安市科学技术局的指导下,由西安市集成电路产业发展中心组织的陕西省半导体应用产业联盟成立大会顺利在西安科技大市场召开。陕西省发改委李春临副主任和高技术处刘迎军处长、西安市科技局高新处郑刚处长等领导出席了本次会议。参加会议的还有西安文理学院、中航工业第 631 研究所、高新区管委会、经开区管委会、中兴通讯、华为西安研究所、华天科技、华芯半导体等省内 50 家半导体领域高校、院所及企业的代表,会议由省发改委刘迎军处长主持。

2012 年,陕西省半导体应用产业联盟在陕西省发改委、西安市科技局和联盟理事会的指导下,将加快联盟秘书处建设,积极配合科技大市场相关工作,积极宣传、推进本地 IC 产品的市场化,为企业搭建新产品推广平台,为联盟成员提供最新信息;同时,重点围绕三星电子落户,整合产业优势资源,促进产业链上下游合作,为三星电子的本地配套服务及本地企业供应链建设提供可行性建设方案,并配合省市及各园区做好产业研究及相关企业落户工作。

广州番禺科信局考察国家集成电路设计西安产业化基地

2012 年 9 月,广州市番禺区科技和信息化局于组织人员分 3 批到国家集成电路设计西安产业化基地考察调研。考察分别由赵仲明局长、董天海副局长等领导带队,广州国家现代服务业集成电路设计产业化基地(广州基地)副总经理陈龙也随团到访。

基地主任何晓宁、副主任周建妮、总工程师韩乐福分别接待了代表团的来访,详细的介绍了西安半导体产业现状并进行座谈。番禺科信局和广州基地的代表对西安基地的发展现状和能够提供的服务及运作方式等内容进行了详细的咨询,并就双方能够产生的合作进行了深入的探讨。广州方面表示西安基地的宝贵经验有许多值得学习和借鉴的地方,希望今后两方基地可以加强联系,展开合作。

“广州国家现代服务业集成电路设计产业化基地”是在 2010 年经国家科技部批准正式成立的,目前基地已引进多家 IC 企业入驻,并引进了一批院士和海归博士。广州基地坐落在广州大学城南部,第一阶段已拥有两万余平方米办公场地,并同步筹建三万余平方米的新办公楼,为基地后续发展提供足够的场地。通过整合集成电路产业相关公共技术服务资源,采用应用带动、政府引导、市场化运作的模式,瞄准珠三角地区电子信息优势行业对集成电路的需求,开展关键技术攻关、技术支持服务和人才培养,建设覆盖珠三角电子信息重点区域的集成电路设计企业技术支持服务体系 and 产业发展配套体系。

陕西省工信厅厅长蒋跃召开集成电路企业座谈会

2012年10月12日上午，陕西省工信厅厅长蒋跃、副厅长许浦生等一行6人，在西安市集成电路产业发展中心（IC中心）会议室举办了陕西省工信厅集成电路重点企业座谈会，陕西省半导体行业协会秘书长、IC中心主任何晓宁接待了蒋厅长一行的来访及座谈。参加此次座谈的还有华为西安研究所所长崔威、西安华芯公司总经理任奇伟、西安华天科技技术总监郭小伟以及西安软件新城发展中心部长王煜等。

蒋厅长一行首先在西安华芯半导体有限公司进行了考察，特别参观了华芯的测试实验室。随后，全体人员在IC中心会议室，就我省目前的产业发展现状、三星落户后对陕西的集成电路产业所产生的影响，以及今后如何推动三星电子与本地产业结合及合作等方面进行了深入的探讨。

大家对于三星电子入驻西安高新区所产生的影响，从不同的方面进行了分析和讨论。大家一致认为，虽然三星的入驻会对部分企业的人员造成暂时的冲击，但是从产业长远的角度来看，三星的入驻对于加快人员聚集、完善集成电路产业链配套，加强本地制造业薄弱环节等，都有着十分重要的推动意义。

“优势科技 物联世界”2012新品发布会成功召开

2012年9月12日，“优势科技2012年物联网新产品发布会”在西安绿地笔克国际会展中心隆重举行。本次发布会是陕西省半导体行业协会会员单位——优势科技继2009在第四届中国民营科技产品博览会上“唐芯一号”发布、2010年北京科博会、2011年深圳国际物联网技术及应用博览会盛装亮相之后，再次在西安举办的重量级新产品发布会。作为“2012中国西部物联网技术与应用博览会”的重大活动之一，业内人士及专业媒体都近距离领略到优势科技国内领先的自主知识产权物联网核心技术与产品的风采。

发布会上，优势科技总经理孙长征向参会人员介绍了优势科技的发展历程和产品体系，重点发布了面向通用市场的唐芯系列芯片“唐芯三号”，这是优势科技此前推出“唐芯一号”、“唐芯二号”之后，再度发布拥有自主知识产权的物联网芯片。本次发布的芯片主要面向通用消费电子市场，其应用涵盖无线键鼠、无线音频、无线游戏、遥控玩具和无线娱乐设备等，充分考虑兼容性与性价比，市场表现令人期待。

除此之外，优势科技重点发布拥有自主知识产权的有源射频识别暨实时定位产品线，以及优势无线传感器网络产品线、优势智慧照明产品线。其产品将逐步应用于智慧城市、智能交通、智慧物流、数字油田、智能车船管理、(涉密)人员资产管理、智能照明、环境监测、无线抄表等多个行业的实际应用。

西安市科技创新大会在陕西宾馆举行

10 月 11 日，西安市科技创新大会在陕西宾馆举行。省委常委、西安市委书记魏民洲，西安市委副书记、市长董军出席会议并作重要讲话。西安市人大常委会主任陈宝根、市政协主席程群力等出席会议，与会领导向西安市科技进步一等奖和市科技成果转化与产业化奖获得者代表颁了奖。

魏民洲强调，要深刻领会全国、全省科技创新大会精神，认真贯彻赵乐际书记、赵正永省长重要讲话精神，强化措施、狠抓落实，不断开创西安市科技创新工作新局面。要大力推进创新驱动发展，坚持科技优先不动摇、服务发展不动摇、重点突破不动摇，为五件大事的顺利实施提供科技支撑。要全面深化统筹科技资源改革，以促进科技与经济紧密结合为重点，加强服务平台建设，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的技术创新体系，加快特色产业园区建设。

魏民洲要求，要加强科技创新人才队伍建设，把培养和引进结合起来，加快培养造就人才，大力引进高层次人才，努力实现由科技资源大市向科技人才强市转变。要进一步优化创新环境，完善科技创新的政策体系，加强对科技创新活动和创新成果的保护，加强创新文化建设。

魏民洲强调，各级党委、政府要自觉把科技改革发展摆在重要位置，逐级夯实责任，加大投入力度，加强督促考核。各区县、开发区要抓紧制定本地区科技创新发展规划，党政领导尤其是主要领导要加强对科技知识的学习，及时解决实际问题。要完善配套政策，形成共同推动科技进步的强大合力。

上海集成电路行业协会带领企业考察西安半导体产业环境

10 月 11 日，上海市集成电路行业协会秘书长蒋守雷及副秘书长王龙兴带领上海新阳、东电电子、中微半导体等近二十家企业总共 30 多人走访了西安高新区和沣东新城，考察了解西安的半导体现状及产业环境，为企业将来在西安的发展做前期准备。

蒋秘书长一行首先来到西安高新管委会，参观了高新区的规划展览馆。管委会副主任陈辉对蒋秘书长一行的来访表示欢迎，详细介绍西安市的产业发展情况，以及高新区的产业布局规划，并协同发改商务局、投资一局、人才中心、集成电路中心等多个部门对蒋秘书长一行进行了接待。集成电路中心副主任周建妮向蒋秘书长一行简单介绍了西安集成电路的产业发展情况。

随后，蒋秘书长一行考察了西安出口加工区 B 区的应用材料西安公司，以及正在建设中的综合保税区，重点参观了三星电子西安项目部。在三星电子项目部，来访人员认真听取了三星项目的建设规划、目前进度，以及三星电子周围的配套规划。最后，蒋秘书长一行考察了西咸新区沣东新城，管委会投资促进局杨滨局长向来访人员表示欢迎，并详细介绍了沣东新城的布局及规划。蒋秘书长对于三星项目的进展速度大加赞赏，对相关政府部门高效的工作效率给予了充分的肯定。

陕西北斗恒通信息科技有限公司荣获西安市科学技术奖励一等奖

在10月11日召开的西安市科技创新大会上，雁塔区重点科技企业陕西北斗恒通信息科技有限公司研发设计的“兼容GPS/BD-2卫星导航与定位接收机集成模块”项目获得西安市科学技术奖励一等奖。

陕西北斗恒通信息科技有限公司成立于2006年，位于雁塔科技园内，是雁塔区重点支持的，专业从事北斗核心芯片和核心技术研发、系统应用开发、项目实施的民营高科技企业。公司研发的射频芯片达到国际先进水平，拥有兼容北斗/GPS的高性能导航接收机技术，承担了全国北斗区域示范应用项目。公司实施的“K63系列斗/GPS/GALONASS多模多通道射频芯片的研发及产业化”项目列入西安市2012年产业技术创新计划，获得了100万元的资金支持。

在全市科技创新大会上，共有122项科技成果获得科学技术奖励，雁塔区24项科技成果获奖，其中一等奖4项，二等奖6项，三等奖11项，科技成果转化与产业化专项奖3项。这24项成果中，10项由区科技局征集推荐，其中科技企业项目8项，院所项目2项；14项由高校院所组织推荐，其中高校项目13项，院所项目1项。

爱立信全球服务中心落户西安高新区

10月23日，世界500强企业爱立信公司全球服务中心落户西安高新区，该中心包括爱立信在东亚首次建立的全球网络运营中心和全球标准化服务中心。据悉，爱立信西安全球服务中心现已拥有300名高技能ICT专业服务人员，并将于近期继续招聘大批具备良好专业素质的新员工，预计2015年员工人数将突破1000人。

瑞典王国驻华大使罗睿德，省政府副秘书长孙安会，市委常委、高新区党工委书记、管委会主任赵红专，市政府咨询员黄省身，市政府副秘书长李彬，高新区管委会副主任陈辉以及爱立信集团执行副总裁兼全球电信专业服务主管马德森，爱立信集团高级副总裁兼爱立信东北亚区总裁马志鸿，爱立信东北亚区高级副总裁兼爱立信（中国）通信有限公司总裁赵钧陶等领导出席了开业典礼。

世界500强企业爱立信公司是全球领先的通信解决方案以及专业服务的供应商，也是世界最大的移动系统供应商。爱立信在全球180个国家拥有超过10万名员工，总部设在瑞典，2011年公司收入达350亿美元。爱立信为运营商提供支持的网络正在为超过25亿用户提供服务，为运营商提供管理的网络正在为超过9亿用户提供服务。

据悉，西安高新区去年引进世界500强企业15家，今年以来又成功引进三星电子、空气化工、西门子、住友、泛亚班拿、普洛斯、NTT DATA、沃尔玛等世界500强企业9家。目前，西安高新区拥有的世界500强及国际知名企业已经超过100多家。

三星电子高端存储芯片项目在西安高新区开工奠基

2012 年 9 月 12 日，在 4 月 10 日签约的 5 个月后，国内最大外商投资项目——一期投资 70 亿美元的三星(中国)半导体有限公司高端存储芯片项目在西安高新区开工奠基。

中共陕西省委书记、省人大常委会主任赵乐际，省委副书记、省长赵正永，省政协主席马中平，省委副书记孙清云，省委常委、常务副省长娄勤俭，省委常委、西安市委书记魏民洲，省委常委、秘书长刘小燕，西安市人大常委会主任陈宝根，市委副书记、市长董军，市政协主席程群力，市委常委、常务副市长岳华峰，市委常委、市委秘书长杨殿钟，市委常委、高新区管委会主任赵红专，市委常委、长安区委书记吕健等领导出席开工奠基仪式。

三星项目的引进，将极大地提升西安半导体产业在国际上的影响力和竞争力，为西安城市形象的提升和国际化大都市的建设注入了活力，对陕西省产业结构调整、提高经济外向度、加快建设新一代信息技术产业高地都具有十分重要的推动作用。

央视《经济半小时》栏目聚焦三星项目西安落户

9 月 12 日，一期投资 70 亿美元的三星(中国)半导体高端存储芯片项目在陕西西安高新区开工。三星为何选择中国、选择西安？三星落户西安，能够为西安带来什么？昨晚，中央电视台财经频道《经济半小时》栏目聚焦三星项目，深入解读三星项目落户的前因，展望三星项目为西安、陕西，乃至于全国的电子信息产业和经济形势带来的影响。

建成后将成为最先进高端存储芯片生产基地

三星电子对华 70 亿美元的高端存储芯片投资项目，是三星电子对华最大一笔投资，是改革开放以来国内电子信息产业最大一笔外商投资项目，也是三星集团迄今为止第二大海外投资项目。三星高端存储芯片项目一期工程位于西安高新区的南端，将于明年年底正式建成投产，“这条生产线建成之后，这里将成为国内乃至世界上最先进的高端存储芯片生产基地”。

跟中国一起共赢铸造西安神话

三星集团大中华区总裁张元基表示，三星投放中国，第一是要谋求三星的发展，第二是要提高中国半导体产业的竞争力，第三是要发展整个半导体产业链。三星的目标是在中国国内，跟中国一起实现共赢。三星项目选择中国、选择西安，无疑是对中国经济、中国消费市场的信心，希望未来能够创造一个双赢的“西安神话”。张元基解释说，“西安神话”是指半导体在西安获得成功，贡献于中国半导体产业竞争力的提高，与三星半导体一起获得美好的结果。

探究选择原因人才和产业是重要因素

《经济半小时》先后采访了西安市委常委、高新区管委会主任赵红专，陕西省委常委、常务副省长娄勤俭。娄勤俭表示，这个项目落户在陕西是必然的。陕西是在中国市场扩散和覆盖的最佳地方。在物流方面，陕西的航空水平在全国也是名列前茅的。同时，水、电、天然气保障，也是陕西、西安的竞争力。

《经济半小时》分析认为，陕西雄厚的科技人才优势和产业配套优势，是三星选择西安的一个重要原因。除了数量众多的高校和科研院所，西安高新区还形成了以英特尔、西谷微电子为代表的半导体设计企业，以应用材料、理工晶科为代表的半导体制造企业，以美光为代表的封装测试企业，随着这些企业的陆续投产，将使西安成为继长三角、珠三角和环渤海湾之后中国第四大半导体产业基地。

三星落户西安让众多世界巨头瞩目西安

美国空气化工产品有限公司全球电子部总裁韦恩接受《经济半小时》采访说，三星在西安落户，一定会吸引更多的相关企业入驻，也会给他们的产品带来更多的市场，因而，未来几年他们将会加大在西安的投资力度。

美国摩西湖工业公司总裁麦克表示，在得知三星高端存储项目落户西安后，他们迅速作出决定，除大连之外，将在西安高新区再建一家专门为三星提供产品服务的工厂。应用材料也表示，随着三星的入驻，他们在中国的市场战略也将随之调整，下一步将把更多的项目带到西安来。

三星带来创新意识、动力、机制、管理

《经济半小时》采访了部分西安在校学生。“三星西安项目主要是闪存芯片，能够为我们提供特别多的实习机会或者是就业机会。”西安电子科技大学关宇恒表示。

西安工程大学教授校长、陕西省半导体行业协会副理事长高勇表示，半导体产业技术要求高、更新快，三星的到来，不仅会使西安聚集更多的高科技人才，也对陕西高校人才培养机制和质量的提升带来挑战。他说：“这个行业除了可以拉动相关的产业以外，也能把产业创新的思想、创新的动力、创新的机制、创新的管理带来，使中国在一个比较好的创新环境下，能够培养更多的创新型人才。”

促进西安基础设施完善推动西安国际化大都市建设

西安市集成电路产业发展中心主任何晓宁表示，三星的到来将使整个产业链更加完善，同时，产业链的比重相对来说会更加均衡。娄勤俭认为，三星项目落户西安，除了巨大的产值提升，更在于其对本地集成电路产业的带动和辐射。会使上下游企业都能享受到更便利的配套环境，降低成本，提升工艺，由此吸引更多的关联企业聚集，实现产业链的真正贯通。三星项目也对西安建设国际化大都市和巩固西部开发桥头堡的区域地位提出了更高的挑战。“外国人来了，花钱怎么花？刷卡方不方便？孩子上学怎么办？这些一系列的基础设施，我们还有差距”。娄勤俭说，因此，三星项目来会促使基础设施完善，这在客观上推动了国际化进程，也推动了西安国际化大都市的建设。

来源：西部网

三星电子项目今西安开工 160 余家配套企业将入驻

备受瞩目的三星电子高端存储芯片项目 9 月 12 日在西安高新区举行开工仪式。这是改革开放以来西部地区引进的最大的外商投资高新技术产业项目。

我省“十二五”期间每年投 2 亿支持信息产业

陕西（西安）投资说明会 9 月 12 日在西安举行，三星物产首席执行官、副会长郑然柱等多位三星高层，以及三星电子相关的配套企业和高端客户代表 70 多人参加了说明会。陕西省委常委、常务副省长娄勤俭，西安市市长董军分别介绍了陕西和西安的投资环境，鼓励电子信息企业落户西安。

董军说，我省计划在“十二五”期间，每年投入 2 亿元资金支持电子信息产业的技术发展、人才引进、发明创造，对创新型企业提供贷款担保、利息补贴等服务。计划到 2015 年西安电子信息产业总产值规模达到 3000 亿元，2020 年达到 6000 亿元。

160 余家配套企业入驻增加万余就业岗位

三星电子项目计划分三期建设完成，预计一期 70 亿美元投资，到 2013 年年底达到设计产能后，每月可生产芯片 10 万片。随着三星项目的落户，将有 160 余家配套企业相继入驻，直接或间接增加万余就业岗位。

来源：华商报

三星首批启动资金 1 亿美元已到账

自 9 月 12 日三星半导体高端存储芯片项目开工以来，西安高新区和三星公司积极推动项目。按照合同约定，三星方面要于今年 11 月底前为项目注资 3.5 亿美元，目前首笔 1 亿美元启动资金已经到账。

为确保三星项目的顺利实施，高新区前移服务窗口，在项目建设工地设立指挥部现场办公，与三星公司方面建立例会制度，协调解决建设过程中遇到的各类问题。

据了解，为加快新一代信息技术产业发展，陕西省、西安市都把新一代信息技术产业作为高新技术产业发展的核心。西安市设立了 40 亿元的发展资金，重点支持信息产业发展。高新区也设立了每年 7 亿元的战略新兴产业专项资金，重点支持信息产业发展。对于重大信息产业项目，还将继续采取省、市、区三级联动以及一企一策的办法，帮助企业生根发展。

目前，西安高新区在半导体领域形成了以英特尔、西谷微电子为代表的半导体设计企业，以应用材料、理工晶科为代表的半导体设备企业，以三星、西岳为代表的芯片生产企业，以美光、华新丽华为代表的封装测试企业，随着这些企业的陆续投产，西安将成为继长三角、珠三角和环渤海湾之后中国第四大半导体产业基地；预计到 2015 年，半导体产业营业收入将突破 1500 亿元。

来源：西安日报

国家规划布局内重点软件企业和集成电路 设计企业认定管理试行办法

第一章 总则

第一条 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)及《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的规定,为合理确定国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业(以下简称“规划布局企业”),特制定本办法。

第二条 国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局(以下简称“认定主管部门”)负责规划布局企业认定工作。

第三条 规划布局企业每两年认定一次,认定资格有效期为两年。

第二章 申报条件

第四条 规划布局企业须同时符合财税〔2012〕27号文件和本办法规定的条件。

第五条 规划布局企业须符合战略性新兴产业发展规划、信息产业发展规划等国家规划部署,在全国软件和集成电路行业中具有相对比较优势。

第六条 符合下列条件之一的软件企业可进行申报:

(一)年度软件产品开发销售(营业)收入总额超过(含)1.5亿元人民币且当年不亏损;

(二)年度软件产品开发销售(营业)收入总额低于1.5亿元人民币,在认定主管部门发布的支持领域内综合评分位居申报企业前五位;

(三)年度软件出口收入总额超过(含)500万美元,且年度软件出口收入总额占本企业年度收入总额比例超过(含)50%。

第七条 符合下列条件之一的集成电路设计企业可进行申报:

(一)年度集成电路设计销售(营业)收入总额超过(含)1.5亿元人民币且当年不亏损;

(二)年度集成电路设计销售(营业)收入总额低于1.5亿元人民币,在认定主管部门发布的支持领域内综合评分位居申报企业前三位。

第八条 认定主管部门可根据产业发展情况对本办法第六条、第七条所规定的申报条件进行必要调整。

第三章 申报材料

第九条 申报国家规划布局内重点软件企业须提交下列材料:

(一)《国家规划布局内重点软件企业申请书》(可从国家发展和改革委员会、工

业和信息化部网站下载);

(二) 企业营业执照副本、税务登记证以及按照《软件企业认定管理办法》取得的软件企业认定证书(以上均为复印件);

(三) 经具有国家法定资质的中介机构鉴证的企业认定年度(企业申请享受优惠政策的起始年度,下同)前两个会计年度(实际年限不足两年的按实际经营年限)财务报表(含资产负债表、损益表、现金流量表)以及企业软件产品开发销售(营业收入)、企业软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况表并附研究开发活动说明材料;

(四) 企业职工人数、学历结构以及研发人员占企业职工比例的说明;

(五) 企业主管税务机关受理签章的企业认定年度前两年所得税汇算清缴年度申报表;

(六) 按本办法第六条第三类条件申报的,应提供商务主管部门核发的软件出口合同登记证书,以及有效出口合同和结汇证明等材料;

(七) 认定主管部门要求提供的其他材料。

第十条 申报国家规划布局内集成电路设计企业须提交下列材料:

(一) 《国家规划布局内集成电路设计企业申请书》(可从国家发展和改革委员会、工业和信息化部网站下载);

(二) 企业营业执照副本、税务登记证以及按照《集成电路设计企业认定管理办法》取得的集成电路设计企业认定证书(以上均为复印件);

(三) 经具有国家法定资质的中介机构鉴证的企业认定年度前两个会计年度(实际年限不足两年的按实际经营年限)财务报表(含资产负债表、损益表、现金流量表)以及集成电路设计销售(营业)收入、集成电路自主设计销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况表并附研究开发活动说明材料;

(四) 企业职工人数、学历结构以及研发人员占企业职工比例的说明;

(五) 企业主管税务机关受理签章的企业认定年度前两年所得税汇算清缴年度申报表;

(六) 认定主管部门要求提供的其他材料。

第四章 认定程序

第十一条 认定主管部门根据相关国家规划研究确定支持领域和认定工作要求,并在申报年度(企业提出规划布局企业资格申请的年度,下同)4月底前发布公告。

第十二条 企业对照公告、财税〔2012〕27号文件和本办法的要求,进行自我评价。认为符合认定条件的,企业可提出认定申请。

第十三条 各省、自治区、直辖市和计划单列市发展改革委、工业和信息化、财政、商务、税务主管部门（以下简称“地方主管部门”）统一受理企业申请，并对企业申请材料进行汇总、核实。对申报材料不全的企业，地方主管部门应于申报年度7月1日前予以告之，并于申报年度8月底前将本地区所有申报企业情况联合报送认定主管部门。

第十四条 认定主管部门建立评审专家库，依据企业申请材料，随机抽取专家库内专家，在申报年度9月底前对申报企业研发水平、经营水平、支撑带动作用等指标进行综合评比（评价指标详见附表）。组织专家评审应符合以下规定：

（一）对国家规划布局内重点软件企业和国家规划布局内集成电路设计企业分别组织专家评审，两个专家组人数分别为11人以上和7人以上单数；

（二）专家组由技术和管理（财务）两方面专家组成，各占约50%比重。技术专家应具有高级职称，管理（财务）专家应具有高级职称或从事相关领域工作15年以上；

（三）与申报企业有直接利害关系的人员不得进入专家组；

（四）专家组成员名单应严格保密。

第十五条 认定主管部门依据国家规划和产业政策、专家评审意见，按部门职责进行综合审查研究后，以总量控制原则择优确定规划布局企业。对符合国家规划布局内重点软件企业条件的重点动漫企业，认定工作商文化部。

第十六条 认定主管部门对获认定的规划布局企业核发证书。

第十七条 获认定的规划布局企业应依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则等有关规定，到主管税务机关办理减税手续。

第十八条 获认定的规划布局企业发生更名、分立、合并、重组以及经营业务重大变化等事项，应当自发生变化之日起15日内书面提请地方主管部门报认定主管部门。地方主管部门和企业主管税务机关在执行政策过程中，发现获认定的规划布局企业不符合申报要求的，应报认定主管部门复核。复核期间，可暂停企业享受规划布局企业税收优惠政策。认定主管部门适时作出保留认定资格、撤销认定资格等决定。

第十九条 中国软件行业协会、中国半导体行业协会及地方相应机构（以下简称“有关机构”）配合开展政策实施情况评估等工作，并将有关情况及时报送认定主管部门。

第五章 工作要求

第二十条 地方主管部门不得限制企业申报。

第二十一条 认定主管部门和地方主管部门工作人员不得作为专家参与评审。

第二十二条 认定主管部门、地方主管部门、有关机构工作人员和专家对所承担工作负有诚信以及合规义务，对申请认定企业的有关信息负有保密义务。

第二十三条 除国家法律法规规定的收费项目外，不得因认定工作以手续费、评审费等名目收取企业费用。

第六章 罚则

第二十四条 获认定的规划布局企业如有下述情况之一的，取消其认定资格，并在 4 年内不再受理其认定申请。未依法纳税的，主管税务机关应当予以追缴。

(一) 在申请认定过程中提供虚假信息；

(二) 有逃避缴纳税款或帮助他人逃避缴纳税款等行为，或因违反《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则受到税务机关处罚；

(三) 在安全、质量、市场竞争行为、公司管理等方面有重大违法违规行为，受到有关部门处罚；

(四) 未及时报告使企业减税条件发生变化的更名、分立、合并、重组以及经营业务重大变化等情况。

第二十五条 认定主管部门须加强对地方主管部门和有关机构工作的监督。对违反本办法规定的地方给予通报批评。对违反认定工作规定的有关机构，视情节轻重给予通报批评、取消工作资格等处罚。

第二十六条 参与认定工作的认定主管部门、地方主管部门、有关机构工作人员和专家如有下列行为之一的，对有关责任人员给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

(一) 违反认定工作程序和工作原则；

(二) 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿；

(三) 违反企业信息保密、认定工作保密等要求；

(四) 其他违反本办法规定的行为。

第七章 附则

第二十七条 原《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》(发改高技(2005)2669 号)，自本办法实施之日起停止执行。

第二十八条 本办法由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局负责解释。

第二十九条 本办法自发布之日起施行。

省发改委补充文件及申请书见我中心网站，网址：

<http://xaic.com.cn/allarticle/shownews.asp?id=10787&cate=1>

SEMI: 全球第二季度半导体设备出货额增长两倍

半导体产业协会数据显示, 全球第二季度半导体设备出货额增长两倍, 高达 91.1 亿美元, 订单额高达 116.8 亿美元。

半导体产业协会(SEMI)公布的数据显示, 2010 年第二季度全球半导体生产设备出货额高达 91.1 亿美元, 较 09 年同期的 26.8 亿美元大幅增长。其中, 北美的半导体生产设备出货额攀升 78%, 台湾的出货额增长两倍, 韩国更是增长四倍多。

同时, 全球半导体设备订单额也高达 116.8 亿美元, 是 09 年同期的四倍。随着经济状况的改善, 企业和个人消费者支出开始恢复, 芯片需求量大幅回升。

SEMI 称, 数据来自全球一百多家设备企业, 是和日本半导体制造装置协会 (Semiconductor Equipment Association of Japan)共同收集的。

来源: 世华财讯

受世界经济影响 Q2 芯片市场需求下滑

IHS iSuppli 经过研究后声称, 欧美市场经济低迷以及中国制造业增速放缓, 直接影响了今年第二季度半导体晶片销量。而就目前的情况来看, 晶片市场需求将在接下来的第三季度持续下降。第二季度全球晶片销量总计为 770 亿美元, 比去年同期销量下降了 3 个百分点, 其中日本和欧洲的半导体厂商首当其冲, 销量下滑最为严重。

IHS 电子和半导体调研部门高级主管 Dale Ford 声称, 目前的全球经济形势将会在接下来的半年时间内持续伤害晶片供应商。IHS 预测 2012 年, 半导体行业的营收增长率将不及去年, 低于 1.4%。另据研究表明, 市场对于 PC 设备需求的减少, 致使一些依赖半导体的 PC 组件例如内存等需求随之减少, 也是导致半导体市场增速放缓的一个重要原因。

根据 IHS 的调研报告显示, 全球市场占有率第一的晶片厂商 Intel 在半导体市场普遍低迷的大环境下, 依旧保持了 3.1% 的增长, 比全行业平均水平多将近 2 倍, 销量超过 120 亿美元, 占据了 16% 的晶片市场; 而紧随其后的三星电子虽然在销量和市场占有率上不及 Intel, 但其年增长率高达 5.8%, 比 Intel 高出了近 1 倍! 总销量将近 76 亿美元, 市场占有率为 10.1%, 成为 Intel 的巨大威胁的挑战。

排名第三的德州仪器公司远不及前两位, 营收下降达 13%, 总销量超过 30 亿美元。高通公司虽然在销量上排名第四, 但是在增长率方面却是遥遥领先。由于在移动设备(诸如智能手机、平板电脑类似)上的优势, 高达 23.7% 的增长率甩开了其他半导体公司几条街, 在普遍低迷的行业经济条件下连华尔街都为止公荣: 总销量超过 28.7 亿美元。

世界晶片生重地日本遭受了严重的打击。由于对 NAND 快闪记忆体的需求增速减缓, 包括东芝、Renesas 在内的日本公司出现了两位数的收入下降。全日本地区整体下

降 4.6%。另据其他市场研究机构如 IC Insight 同样表示,日本的半导体公司“很受伤”。而欧洲方面情况更糟,报告称欧洲地区半导体公司收入整体减少 8.3%。

来源: 新浪科技

德州仪器撤出手机芯片市场: 新一轮洗牌开始

快速增长的智能手机芯片市场领域,德州仪器率先撤退,喊出“不玩了”。德州仪器日前宣布,该公司将把投资重点从移动芯片转向更广泛的市场,包括为汽车生产商等工业客户供应产品,从而发展利润更丰厚、业绩更稳定的业务。

美国市场研究机构 Strategy Analytics 的数据显示,德州仪器在智能手机芯片市场上的份额一直稳居市场前列。德州仪器的突然退出,是竞争加剧的“主动抉择”,还是无力投资的“被动出局”?种种迹象,预示智能手机芯片行业已经开始新一轮洗牌。

德州仪器率先撤退 “不玩了”

“物竞天择,适者生存”不只是生物进化的法则,也是企业市场竞争的基本规律。在智能移动终端市场中,德州仪器设计的 TI OMAP 处理器有着较高的知名度和不小的市场份额,但随着竞争加剧,市场对 TI OMAP 处理器的需求量正逐步萎缩。

Strategy Analytics 公布的 2012 年上半年全球智能手机芯片市场报告显示,高通占据了 48% 的营收市场份额,排名第一;德州仪器的排名由此的前三名滑落至第五名;三星、联发科、博通则分列第二、三、四位。

德州仪器市场份额逐步减少,与其缺乏完整的解决方案有关。据业内人士表示, TI OMAP 处理器是很出色的应用芯片,但是一直缺乏完整的 3G 和 4G 基带芯片,而目前很多的移动制造商都相对青睐具有完整解决方案的芯片厂商。

“德州此前已经退出了基带芯片市场,如果只做应用处理器,也就失去了协同效应。”手机中国联盟秘书长王艳辉告诉新浪科技,“应用处理器市场竞争太过激烈,德州仪器将很难保持较高的毛利率,也不利于公司整体的财务表现。”

根据德州仪器的财报显示,在过去 10 个季度中,德州仪器包括智能手机芯片业务在内的无线部门营收出现了严重的下滑趋势,今年第一季度和第二季度里接连出现了运营亏损。

王艳辉认为,德州仪器放弃应用芯片市场转向利润率更高的嵌入式芯片市场,财报可能更亮丽,也更容易获得华尔街的认可。

IC 元器件电商科通芯城执行副总裁朱继志指出,德州仪器的退出颇为无奈。“德州仪器往高端智能手机芯片市场发展,很难与高通、三星等展开竞争;而如果往低端市场发展,实际上又竞争不过联发科、展讯等厂商。”

亚马逊接盘,靠不靠谱?

随着德州仪器宣布退出移动芯片市场,有关其出售该部分业务的消息也逐渐升温。据以色列财经报纸 Calcalist 周一报道,亚马逊正在与德州仪器旗下智能手机芯片业务部门展开谈判,计划对后者进行收购,从而进入智能手机芯片领域。

亚马逊 Kindle Fire 平板电脑正在使用德州仪器的处理器。有分析师认为，通过收购可能使亚马逊更好地进行软硬件垂直整合。科通芯城执行副总裁朱继志对这种观点表示认可：“亚马逊如果收购，其实并不奇怪。”

朱继志表示，“软硬一体化已经成为行业发展趋势，现在各家公司软件平台基本一致，如果要体现出差异化，只能在硬件上寻求突破，而芯片便是其中的核心部分。”他说，在软件方面，亚马逊已经与谷歌 Android 达成深度合作，现在它需要搭建一个自己的硬件平台。

华登国际投资总监苏仁宏则认为亚马逊不会进行收购。他在微博上写道：“有朋友问，如何看亚马逊收购德州仪器移动芯片业务传闻？答：你相信卖牛奶的超市，要去种草吗？”他认为，亚马逊没有做大手机业务之前，收购手机芯片业务，只会是个沉重的负担。

手机芯片市场加速洗牌

一直以来芯片都是一个需要高投资的领域，尤其在竞争激烈的智能手机芯片市场，技术变化很快，更需要厂商进行长期、持续的投资。

目前主流智能手机芯片以单一制式为主，如 WCDMA、CDMA、LTE 等，但未来进入 4G 时代之后，手机基带芯片全模全制式可能会成为趋势。实际上，高通和联发科已经在进行相关研发。

瑞芯微电子首席市场官陈峰表示，基带芯片支持全模全制式后将不用再针对区域市场进行研发，这可以共享研发成本。他认为，这种芯片未来将主要用在高端手机芯片领域，在中低端的手机芯片领域可能还是以单一制式的芯片为主。

iSuppli 半导体首席分析师顾文军认为，这样的发展趋势将会给基带芯片研发带来一些现实的问题：一、研发费用加大；二、对专利的要求更高。“这基本意味着只有巨头公司能参与竞争，未来市场上可能只剩下 2-3 家企业。”

Strategy Analytics 数据显示，2012 年上半年全球智能手机芯片市场规模达到 55 亿美元，高通、三星、联发科、博通、德州仪器等 5 家企业垄断大部分市场，留给其他厂商的份额可能只有 10% 左右。

面对严峻的产业发展趋势，国内手机芯片企业在资金匮乏、高层次人才偏少、专利缺失的情况下发展更不容乐观。不过，这并不能阻挡但展讯和华为旗下的海思等厂商活跃在中低端智能手机市场的舞台。

王艳辉认为，国内智能手机芯片厂商落后于欧美企业，目前尚处于跟随阶段。“未来在高端智能手机芯片市场，欧美企业会形成垄断，但是在低端市场，国内企业仍有很大的市场空间。”

中国、非洲等新兴市场正在从功能手机向智能手机时代过渡，这是一个巨大的机会。面对当下的机遇与挑战，国内企业必须先生存下来，进而提高技术参与竞争，才有机会在智能手机芯片市场中谋得一席之地。

来源：新浪科技

半导体蚀刻设备厂商 Lam 一财季盈利下滑 96%

半导体蚀刻设备厂商 LamResearchCorp 周三发布第一季财报。数据显示, 由于该公司的利润空间进一步被压缩, 且并购芯片设备制造商 NovellusSystems 所导致的成本, Lam 的盈利水平较上年同期下滑 96%。在发布这一财报消息后, 尽管盈利水平下滑, 但业绩好于早前市场分析师的预测, Lam 的股价在周三的盘后交易中上涨 2% 至每股 34.26 美元,

Lam 在对外发布的一份财报声明中表示, 在截至今年 9 月 23 日的第一财季里, 该公司的盈利从上年同期的 7180 万美元下滑至 277 万美元, 每股盈利从上年同期的 58 美分下滑至 2 美分。在不计并购成本以及其他项目的情况下, Lam 的每股净收益为 53 美分。营业收入较上年同期增长 33% 至 9.069 亿美元。

早前汤森路透曾对市场分析师进行了调查, 按照他们的测算, 预计 Lam 的每股盈利为 41 美分, 营业收入为 9.04 亿美元。

财报数据还显示, 在第一财季里, Lam 的总利润率从上年同期的 41.7% 下滑至 36.8%。运营费用较上年同期增长 72% 至 3.172 亿美元。

截至本周三收盘, Lam 在过去的 12 个月里累计下滑约 21%。

来源:腾讯财经

IC Insights: 2012 年电信相关 IC 成长居冠

ICInsights 指出, 虽然 2012 年整体 IC 市场成长率预计将下降 1%, 但仍有九大产类别预计将出现正成长, 其中前三名均与电信产业相关。有线电信应用的特殊应用类比元件市场预计在 2012 年会强劲成长 25%, 其次是有线通讯和无线通讯的专用逻辑/MPR 产品类别。

智能手机和平板电脑用的特定应用处理器被定义在无线电信的专用逻辑/MPR 类别中, 是推动该领域强劲增长的主要驱动力。另外, 在专用逻辑/MPR 部份, 包括消费和工业及其他类别今年也都将呈现正成长。显示驱动器预计 2012 年将成长 2%。ICInsights 指出, 对智能手机的需求、平板电脑的普及, 以及预计新的超轻薄笔电 (ultrabook) 的市场成长潜力都有助今年显示驱动器的销售。

而 NAND 快闪记忆体则是在成长速度已逐渐趋缓、更多厂商加入角逐, 加上产能不断增加的条件下, 仍连续三年名列成长最快速的前十名之列, 但这也让 NAND 记忆体的平均销售价格(ASP)在 2011 年持续下滑, 而且还维持到了 2012 年。

汽车市场仅占总 IC 销售总额的 7% 左右, 但预估汽车内部电子系统使用的元件量增加, 也将让汽车专用的逻辑/MPR 成为成长最快速的 IC 产品。另外, 先进的汽车应用如停车系统、稳定度控制系统、碰撞防止系统等, 都是推动 32 位元微控制器(MCU) 快速成长的关键。

来源: EETimes-Taiwan

中盛光电挺进南非光伏市场

全球领先的一站式太阳能电力解决方案提供商——中盛光电集团 ET Solar GroUP（下称“ET”、“中盛光电”或“中盛”）日前宣布与 Flexopower 能源有限公司合作的首个屋顶光伏电站项目已并网发电，这是中盛光电组件产品在南非的首次应用，标志着中盛光电正式挺进南非市场。

该屋顶电站项目装机容量为 10.12 千瓦，坐落在南非约翰内斯堡市郊的 Kya Sand。今年 8 月底，项目顺利实现并网发电。中盛光电为项目提供高效的光伏组件产品；Flexopower 能源有限公司作为当地知名的 EPC 公司，为项目提供全面的工程、采购和施工等 EPC 服务。

中盛光电集团总裁兼首席执行官余海峰说：“中盛组件成功应用于南非光伏电站项目值得欣慰，它为我们开拓南非市场树立一个良好的开局。作为新兴的光伏市场，南非光伏产业的商业模式日渐明晰，发展潜力巨大。我们将与 Flexopower 一起努力，扎根南非市场，挖掘市场潜力，为当地居民带来更多的清洁能源解决方案。”

Flexopower 能源有限公司董事 Werner Fischer 说：“很荣幸与中盛光电开展电站项目的合作，中盛光电高品质的光伏产品与服务让我们印象深刻，也为项目的顺利实施提供了有力的保障。这个 10.12 千瓦屋顶项目是我们合作的第一步；后期，我们还将与中盛光电强化合作关系，开展更多电站项目的协作。我们也对未来合作前景充满信心。”

关于中盛光电

中盛光电集团是全球领先的一站式太阳能电力解决方案提供商，本地化的营销分支机构及办事处遍布亚洲、欧洲和北美，为全球 50 多个国家和地区的客户提供太阳能组件、解决方案等产品和服务。

来自：美通社

欧洲太阳能市场比重 2012 年将不到 5 成

欧洲太阳能市场在当地财政困窘、补贴费率持续下滑下，在全球太阳能市场的重要性降低，今年恐怕不到 5 成水准，工研院 IEK 产业分析师王孟杰表示，欧洲市场成长已趋缓，新兴市场已逐渐成形，太阳光电市场由单一大市场将往多元小市场发展，在新市场中，考量到政策、财力、执行力等客观条件，则以美/日为首选、印/澳也相当具有发展。

IEK 预估，2012 年全球系统量约 25-29GW，其中，欧洲占比重 48.5%、亚太占 26.8%、北美占 15.4%、南亚占 3%。

王孟杰表示，过去我国于欧洲出口占比重达 5 成以上，中国则占 23% 次之，但欧洲因安装逐渐饱和以及政策紧缩，比例大幅下滑，而以美加为中心的美洲地区出口比

例大幅提高，中国则因双反制裁对台转单增加，但价格被压的更低，故出口值比例并未有太大改变。

而考量到经营风险以及市场发展潜力的权横，IEK 认为，新兴的太阳能市场中，第一线可拼抢市占的为美国/日本市场，而第二线则以澳洲/印度为选择。

对于首选的美国市场，IEK 产业分析师丁凡认为，美国市场稳定成长，具有政策利多，大型地面电厂与屋顶系统发展齐头并进成长力道佳，但对系统价格要求较高，且美国两党对再生能源发展态度迥异，将影响未来发展；日本市场则因 311 地震后去核化的政策驱动，享有全球最高的补助政策优惠，更推升大型地面电厂的需求，但每度电 42 日圆补助的高优惠至明年 3 月，故宜抢快装设。

而在第二线澳洲市场部分，丁凡指出，澳洲相具有良好日照条件，因高电价使过去小型住宅屋顶系统市场蓬勃发展，在碳税制度和政府旗舰计划（SolarFlagships）下，未来可望推升大型电厂的市场，且澳洲市场在亚太中相对开放，有利外来厂商进入；而在印度市场，丁凡指出，印度具有良好的日照条件以及政府的政策利多，但基础设施落后，且市场偏好低价产品，压缩厂商获利。

来源：精实新闻

进口太阳能级多晶硅量增价跌 倾销继续加大

硅业分会据最新海关统计数据显示，7 月份我国多晶硅进口为 7124 吨，环比增长 8.2%；1-8 月份累计进口量达到 5.6 万吨，同比增长 32.8%。从进口单价来看，8 多晶硅进口平均价格再次创新低为 24.23 美元/千克，环比下滑 5.2%，而 1-8 月份多晶硅的进口单价也被拉低至 26.92 美元/千克，较 2011 年全年平均价格下滑 54.2%。

从 8 月份分国别进口数据来看，从韩国、美国、德国三国进口量占全部进口量的 87.8%，其中，韩国的市场份额为 21.9%；美国的市场份额为 45.5%；德国的市场份额为 20.3%。同时，韩国、德国的进口单价较 7 月份都出现不同的下滑，分别为 23.33 美元/千克和 29.1 美元/千克；而美国的进口单价小幅回升，为 21.7 美元/千克，但是其价格依旧是三国之中最低的。

进口多晶硅量增价跌的情况已经持续近一年，这种持久的大幅倾销已经严重损害了国内多晶硅产业的发展，目前国内多晶硅企业开工率较上半年明显下滑，其中包括中硅、赛维在内的多家企业都已经处于停产或半停产的状态，国内最大的多晶硅企业江苏中能也大幅减产，整个产业正面临生死存亡的阶段。

同时，据海关统计数据显示，8 月份我国多晶硅出口仅为 166 吨，累计出口为 897 吨。

来源：硅业分会

台 LED 厂 Q3 背光接单表现续强 大力带动营收成长

受到大陆 LED 电视拉货带动，台湾 LED 厂第三季背光接单表现续强，带动 LED 厂第三季营收成长表现，晶粒厂晶电(2448)、璨圆(3061)，封装厂亿光(2393)、东贝(2499)，垂直整合厂隆达(3698)第三季皆维持季增成绩，其中，非晶电阵营的璨圆与东贝在平板电脑接单加持下，分别有季增 9.86%与 41%的亮眼成绩。

LED 晶粒龙头厂晶电 9 月非合并营收 16.16 亿元（新台币，下同），月减 6.08%，年增 14.82%，9 月营收下滑的主因在于四元 LED 产品进入淡季影响，不过，相较之下，背光产品接单仍续强，其产能将持续满载至 11 月。晶电第三季整体营收 42.63 亿元，季增 2.16%；璨圆受惠于 LED 电视拉货强劲的带动，加上接获平板电脑订单，璨圆 9 月营收 4.6 亿元，较 8 月营收持续成长 1.78%，第三季营收达 13.54 亿元，季增率则有 9.86%。

而就下游封装厂来看，亿光 9 月营收受到消费性电子客户的库存增加影响，加上传统封装元件 LAMP 订单表现较弱，导致 9 月营收仅 14.71 亿元，下滑 6.76%，但仍比去年同期增加 8.78%；亿光整体第三季营收达 44.69 亿元，季增 3.68%，年增 10.39%，符合市场的逐季成长预期。相较之下，东贝则在 LED 电视与平板电脑双马车拉动下，9 月营收 9.02 亿元，续创单月营收历史新高，月增 7.5%，第三季合并营收 25.2 亿元，季增 41%的亮眼成绩。

垂直整合厂隆达第三季也在背光产品与照明产品接单状况良好带动下，9 月营收 10.07 亿元，较 8 月持续成长 4.4%，年增 13.2%，整体第三季营收达到 28.94 亿元，较第二季成长 10.8%，年增 14.9%。

来源:LED 制造

洲明科技：中标财政补贴半导体照明产品 36 万只

10 月 8 日，洲明科技发布公告称，该公司近日收到国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、科学技术部办公厅下发的《关于组织开展 2012 年度财政补贴半导体照明产品推广工作的通知》。

根据该文件，洲明科技 2012 年度半导体照明产品推广限额总量共计 36 万只，其中，室内照明产品 30 万只，包括 LED 筒灯(规格/功率为:4 寸/8W、6 寸/14W 和 8 寸/18W)和 LED 射灯(规格/功率为:PAR20/8.5W、PAR30/13W 和 PAR38/12W)；室外照明产品 6 万只，包括 LED 隧道灯(规格/功率为:5400lm/58W、9000lm/100W)和 LED 路灯(规格/功率为: 9000lm/100W、14000lm/170W)。

公告称，推广限额内的销售，可按照国家相关政策享受补贴。2012 年度财政补贴推广的 LED 照明产品仅限在中国大陆销售，不限制推广地区。

来源: LED 制造

LED 照明缺乏标准 台湾业界呼吁推迟家用 LED 灯补助

照明业者担忧 LED 照明国家标准(CNS)未出炉,经济部却打算针对家用 LED 灯泡,每颗补助 2 百元,恐出现劣币驱逐良币,生产劣质低价品的业者成为最大赢家。台湾区照明灯具输出业同业公会理事长张孔诚昨日带队拜会标准局时,敦促标准局加快制订 LED 照明国家标准脚步。

据不愿具名的照明业者指出,经济部标准局为落实政府节能减碳政策,草拟台湾 LED 照明标准多年,但时至今日尚未正式实施,照明业者根本没有送检验测试的机会。为此,张孔诚 10 月 8 日拜会标准局局长陈介山,希望标准局加快制订 LED 照明国家标准。不过业者完全没想到经济部突然宣布 1 个月内,针对家用 LED 灯泡提出补助政策,业者直言,连标准都没有,要怎么补助呢?

业者指出,经济部为鼓励民众节能减碳,有意仿效节能家电(冰箱、洗衣机、电视及冷气)补助政策,计画近期提拨 10 亿元新台币经费,针对家用 LED 灯泡,每颗最高补助 2 百元,以家户为单位,每户补助 5 至 10 颗 LED 灯泡,预计今年年底前实施。

而 LED 照明迄今并无 CNS 标准,这与今年两波节能家电补助,系以节能标章作为补助依据,截然不同。国内目前生产 LED 灯泡厂商至少 4、50 家,生产品质却良莠不齐,业者担心,LED 照明若无 CNS 标准作为补助依据,未来可能出现专事生产低价 LED 灯泡厂商,使用寿命未达测试标准,却凭借价格优势而席卷大半市场,出现劣币驱逐良币。

因此,台湾业者强烈呼吁经济部,要先推出 LED 照明国家标准,再对家用 LED 灯泡做补助。

来源:高工 LED 综合报道

三安光电子公司 LED 外延项目获政府补贴 2000 万元

10 月 8 日,三安光电发布公告称,其全资子公司安徽三安光电有限公司于 9 月 29 日收到芜湖市发展和改革委员会《关于转发 2012 年战略性新兴产业(节能环保)项目中央预算内投资计划的通知》,安徽三安高效节能半导体照明 LED 外延及芯片产业化项目获得安徽省 2012 年战略性新兴产业(节能环保)项目中央预算内投资 2000 万元人民币。同时,根据财政部《关于拨付各地 2011 年度进口产品贴息资金的通知》文件核定的进口产品贴息标准,安徽三安获得进口贴息资金人民币 1581.4 万元。

另外,三安光电控股子公司日芯光伏科技电有限公司于 9 月 30 日收到淮南高新技术产业开发区财政局《关于拨付日芯光伏芯片应用与研发专项补贴款得通知》,根据文件内容,日芯光伏获得财政专项补贴款 3000 万元,用于公司芯片与研发补贴。

三安光电表示上述款项于收到时确认为递延收益,并在项目受益期内分摊计入损益。

来源:中国 LED 供应网

通用首款移动支付服务 MOBITO 在捷克问世

全球最大的基于智能卡技术的安全和身份识别解决方案和服务提供商之一 Oberthur Technologies 携手其最近收购的位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的移动支付服务子公司 MoreMagic Solutions 一起于 2012 年 10 月 22 日宣布, 该公司已经被选作 MOBITO 的独家技术合作伙伴。MOBITO 是在捷克提供的一项具有突破性的移动支付服务, 堪称全球同类首创。MOBITO 由 MOPET CZ 于 9 月份推出, 目前捷克境内的所有手机用户无论采用哪家银行的服务均可使用此项服务。

MOBITO 能为捷克各地的人们提供一种通过现有移动设备(不管是功能手机还是智能手机)进行安全、便捷支付的方式。MOBITO 用户可以享用各种广泛的服务, 例如交通、购票、在线购物以及咖啡厅、酒馆、超市店内消费付款等。用户可以使用 MOBITO 服务付款, 通过银行账户、预存现金账户(手机钱包)或使用信用卡/借记卡直接支付。用户还可以使用 MOBITO 给他们的手机账户充值, 并进行相互转账。

Oberthur Technologies 将运用 MoreMagic 移动资金平台及其丰富的移动和智能手机应用套件, 支持 MOBITO 提供全套移动金融服务, 从而为捷克全境实现远程支付以及 NFC 和非 NFC 近距离支付铺平道路。此项服务全面符合欧盟电子货币标准和捷克银行法规。

出处: RFID 中国网

全球最大 RFID 设备厂商进军中国物联网市场

无锡新区太湖国际科技园 10 月 20 日与全球最大物联网核心设备供应商德国纽约集团正式达成一项签约, 后者将投资 2000 万欧元用于在“感知中国中心”江苏无锡打造物联网核心行业 RFID 产业基地, 该基地也将作为该公司在华的物联网关键设备总部研发中心。

德国纽约集团是世界唯一可提供总体全自动 RFID 标签生产方案的公司, 也是全球最大高科技智能卡、智能标签、半导体器材下游产品等全自动生产设备独立供应商, 市场份额占全球 80% 以上。

近年来, 国内物联网产业俨然成为最热门的新兴产业, 其中尤以 RFID(俗称电子标签)产业蓬勃增长为标志。据中国 RFID 产业联盟统计, 2011 年, 中国自主 RFID 产业市场规模达 179.7 亿元, 同比增长 47.9%, 随国内物联网应用市场的逐步启动, 预计 2012 年, 中国 RFID 市场规模可达 270 亿元, 进入良性循环发展黄金期。

另悉, 针对国内 RFID 产业行业应用标准缺失、监管混乱现状, 由香港科技大学、上海交通大学无锡研究院、无锡市新区质监局和传感网大学科技园管理中心等四方合作的 RFID 检测认证中心同时在无锡新区成立, 将就国内 RFID 领域相关产品开展认证、测试和行业标准制定。

来源: 中新网

英特尔发布 Win8 平板专用处理器 Z2760

9 月 28 日消息，英特尔刚刚在旧金山发布了 Windows8 平板电脑的专用处理器，即凌动 Z2760，这也被看作是 intel 同 ARM 在 Windows 平板电脑上的首次交锋。

自从 Windows8 宣布首次支持 ARM 芯片后，其平板产品可支持 ARM 和 X86 架构的关系动摇了多年稳固的 Wintel 联盟。而 intel 发布的 Z2760 也是在用产品和 OEM 深度关系证明，在 Windows 平台上自己还有不少优势。

根据官方介绍，Z2760 是一颗双核的 SoC 芯片，并采用 32 纳米制程工艺，最高频率可达 1.8Ghz。

新处理器将基于 CloverTrail 核心，这是一个最新发布处理器核心，被英特尔定义为与 ARM (SOC) 芯片竞争的产品。

英特尔表示，基于 Z2760 的平板电脑可以做到长时间待机：其可支持长达 3 周的联机下待机和 10 小时的 HD 高清视频播放。

英特尔移动通信事业部应用处理器平台业务总经理 ErikReid 表示，这只是 intel 在平板电脑市场的开始，而公司的目标是希望打造让消费者和企业级平台都有完美体验的平板产品。

来源：网易科技

中芯国际推出 0.13 微米 1.2V 低功耗嵌入式 EEPROM 平台

中芯国际 2012 年 9 月 19 日宣布推出其 1.2 伏低功耗嵌入式 EEPROM 的平台，与其 0.13 微米 (um) 低漏电 (LL) 工艺完全兼容。该平台经过流片以及 IP 验证，在降低功耗、芯片尺寸和成本的同时，能提高数据的安全性。这个新平台为中芯国际的成熟工艺节点提供了最新的增值服务，主打中国快速发展的双界面金融 IC 卡市场及全球非接触式智能卡市场。

与 0.18 微米 EEPROM 技术相比，该 0.13 微米平台减少了约 50% 的芯片面积，同时降低了约 50% 的功耗。还可选用高速缓存控制器，在低功耗的同时加快读取速度，为客户提供了更大的设计灵活性。该平台集成了 EEPROM、ROM、VR、OSC、I/O、存储器编译器和光检测器(lightdetector)IP。除了上述中芯国际自己研发的 IP，存储器编译器方面亦提供第三方 IP 的选择。以中芯国际 0.13 微米 LL 技术构建的设备将支持温度范围从-40 摄氏度到 85 摄氏度完整的读取和编程操作，并且在 55 摄氏度的温度下，10 万读取和写入周期后，还能保证至少 30 年的数据保存(等同于在室温下超过 300 年的数据保存)。该平台目前正在通过一百万次读取和写入周期的品质验证。

中芯国际商务长季克非表示，"年底将有银行 IC 卡产品在这一新平台投片，我们为客户的积极反响感到鼓舞。根据我们多年 0.18 微米 EEPROM 的量产经验以及客户的反馈，我们预期该技术将快速上量并带来强劲的市场需求。"

来源：美通社

赛灵思推出基于 ARM 处理器的汽车级平台

在 2012 年 10 月 16 日-17 日在美国底特律举行的汽车工程师协会 Convergence2012 大会上，赛灵思推出了基于 ARM®处理器的汽车级 Zynq™-7000 片上系统（SoC）平台。该平台通过可编程系统集成，在降低材料清单（BOM）成本的同时，能够满足那些要求具备图像到视觉功能（对保障驾驶员安全至关重要）和车载网络功能的系统的尖端技术要求，从而可以降低驾驶员辅助解决方案的成本，并加速上市进程。

赛灵思公司汽车业务部总监 NickDiFiore 表示：“ADAS 市场领域正在快速发展，赛灵思汽车级 Zynq-7000AllProgrammableSoC 是支持汽车行业加快 ADAS 技术部署的关键。Zynq-7000 系列使 ADAS 开发人员能够将熟悉的软件系统与完全定制的硬件加速器紧密结合，从而实现传统多芯片方案无法企及的原始图像处理性能和低功耗优势。”除了性能优势，赛灵思汽车（XA）Zynq-7000AllProgrammableSoC 之所以成为 ADAS 应用的理想选择，还在于它能满足汽车应用严格的温度、质量和可靠性要求。

目前的 ADAS 解决方案一般采用多个芯片，赛灵思用 Zynq-7000 系列避免了这一问题。Zynq-7000 是业界首款在单芯片上将 ARM 双核 Cortex™-A9MPCore™处理系统与紧密集成的可编程逻辑完美结合在一起的 SoC 系列。这种完美结合不仅能大幅提升处理密集型实时 ADAS 的关键性能，而且还可实现更高的系统集成度，便于捆绑多种应用并减少材料清单成本。

来源:中国半导体行业信息网

博通推出世界首个 28nm 多核通信处理器系列

10 月 17 日消息博通（Broadcom）公司今天宣布，推出低功耗 28nmXLP200 多核通信处理器系列，这款新的优化解决方案可以满足企业、4G/LTE 运营商、数据中心、云计算和软件定义网络（SDN）对性能、可扩展性和效率等方面的需求。

博通方面表示，今天推出的新产品系列是对博通公司成功整合 NetLogicMicrosystems 的有力证明，同时大幅拓展了博通公司在 30 亿美元通信处理器市场中的供货范围。XLP200 系列目前正在试样，量产时间定于 2013 年下半年，有多种型号和配置可供选择。

据介绍，博通公司的 XLP200 系列是世界首个 28nm 多核通信处理器系列，其处理速度比竞争产品快多达 400%，同时功耗降低多达 60%。可为数据平台、控制平台和异构应用提供最佳性能的 XLP200 系列是业界唯一在单个芯片上结合了四发射、四线程和 2GHz 乱序执行功能，并具有网络集成和安全加速功能的通信处理器系列。

此外，与全球领先网络设备公司合作开发的 XLP200 系列在产品中整合了第四代正则表达式（RegEx）语法处理引擎，以及广泛的自主加密和认证处理引擎，可以提供全面的 7 层数据包检测（DPI）功能，并将计算密集的安全功能从 CPU 上完全卸载下来。

来源:中国半导体行业信息网

关于成立西安微电子高级技工培养基地的通知

随着大量的生产性企业入驻西安，西安集成电路企业最为担心的是生产线操作工的培养和获取，西安市集成电路产业发展中心作为西安市集成电路产业唯一一家综合性服务单位，将努力推动集成电路产业在西安本地的发展，为此，西安市集成电路产业发展中心将联合西安理工大学共同成立西安微电子高级技工培养基地，旨在培养符合微电子相关的生产制造厂商技工人才，缓解目前操作工紧缺的局面。

培养基地成立后将致力于培养微电子相关的封装、测试及制造的操作工及技工人才，根据市场需求和产业发展，制定适合工业界用人的系列教程和教材，缓解目前西安制造业高级技工短缺的现状。

成立仪式拟在 11 月份在西安科技大市场举行，届时合作双方将签订长期的合作协议，邀请企业和学生代表参加。

联系人：曹阳 联系电话：88328230-8028

关于举办爱德万测试技术研讨会的通知

随着三星电子入驻西安，西安本地集成电路产业链日趋完善，测试需求也日益增加，为了给本地产业创造更好的发展条件和环境，西安市集成电路产业发展中心特联合爱德万公司预计在 11 月下旬在西安举办技术研讨会，欢迎届时前来参加。

联系人：张蓓 联系电话：88328230-8012

关于开展“第七届（2012 年度）中国半导体创新产品和技术评选”活动的通知

会员单位及有关单位：

在国内外宏观经济环境复杂多变，我国电子信息产业总体增幅回落的市场背景下，经过全行业的共同努力，预计 2012 年我国半导体产业将实现平稳发展。未来，我国半导体产业既面临移动互联应用的市场商机和战略性新兴产业发展的难得机遇，也面临竞争和下行压力加大的风险，因此，必需加快产品和技术创新的步伐，实现从中低端向中高端跨越。为进一步鼓励我国半导体企业自主创新，增加我国半导体产业的核心竞争能力，在工业和信息化部有关司局的指导下，中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会和中国电子报社将继续举办“第七届（2012 年度）中国半导体创新产品和技术评选”活动。

评选活动方案（附件一），评选申报表（附件二），

下载地址一：www.cena.com.cn 下载地址二：www.csia.net.cn

申报截止日期 2012 年 12 月 10 日。

关于举办“中国集成电路设计业 2012 年会暨重庆集成电路创新发展高峰论坛”的通知

2012 年是国家工业和信息化部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》的第一年，作为战略性新兴产业的核心和基础，集成电路产业进入了新的十年黄金发展期。2012 年 5 月，财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)，是我国集成电路产业，特别是集成电路设计产业发展新十年的助推力。

新十年，机遇与挑战并存。我们必须具备更强的实力，更扎实的基础，不断增强创新胆识，提升创新能力，实现中国集成电路设计产业发展的新突破。

中国集成电路设计业年会在我国集成电路设计产业的发展中发挥了越来越大的作用。年会的主题与会议主办地电子信息产业发展实际相结合，推动了各主办地的相关产业与我国集成电路产业同步发展。

为进一步推动集成电路产业发展，结合重庆的地域优势，统筹东西部产业资源，培育核心技术，实现新十年跨越式发展，特定于 2012 年 12 月 6 日-7 日在重庆举办“中国集成电路设计业 2012 年会暨重庆集成电路创新发展高峰论坛”。

本次年会以“开拓创新，发挥优势，优化产业结构，打造电子信息产业高地”为主题，深入探讨集成电路产业，特别是集成电路设计业面临的机遇和挑战；探讨提升企业基础能力，增强产业整体能力的途径，以满足市场的需求和提高国际竞争力需要。大会将为集成电路产业链各个环节的企业营造一个交流与合作的良好平台，为世界各地和港、澳、台的同行以及相关行业协会、中介组织等构筑一个与中国集成电路设计企业在技术、市场、应用、投资等领域互换信息、探讨合作的交流平台。大会将对促进产业整合，提升核心竞争力，实现产业规模化快速发展产生深远影响。

时间：报到时间：2012 年 12 月 5 日（周三）

会议时间：2012 年 12 月 6 日-7 日

报到地点：重庆申基索菲特大酒店

会议地点：重庆国际会展中心

详情请登录 [Http://www.cqsia.org](http://www.cqsia.org), [Http://www.cqsia.org](http://www.cqsia.org) 网站查询